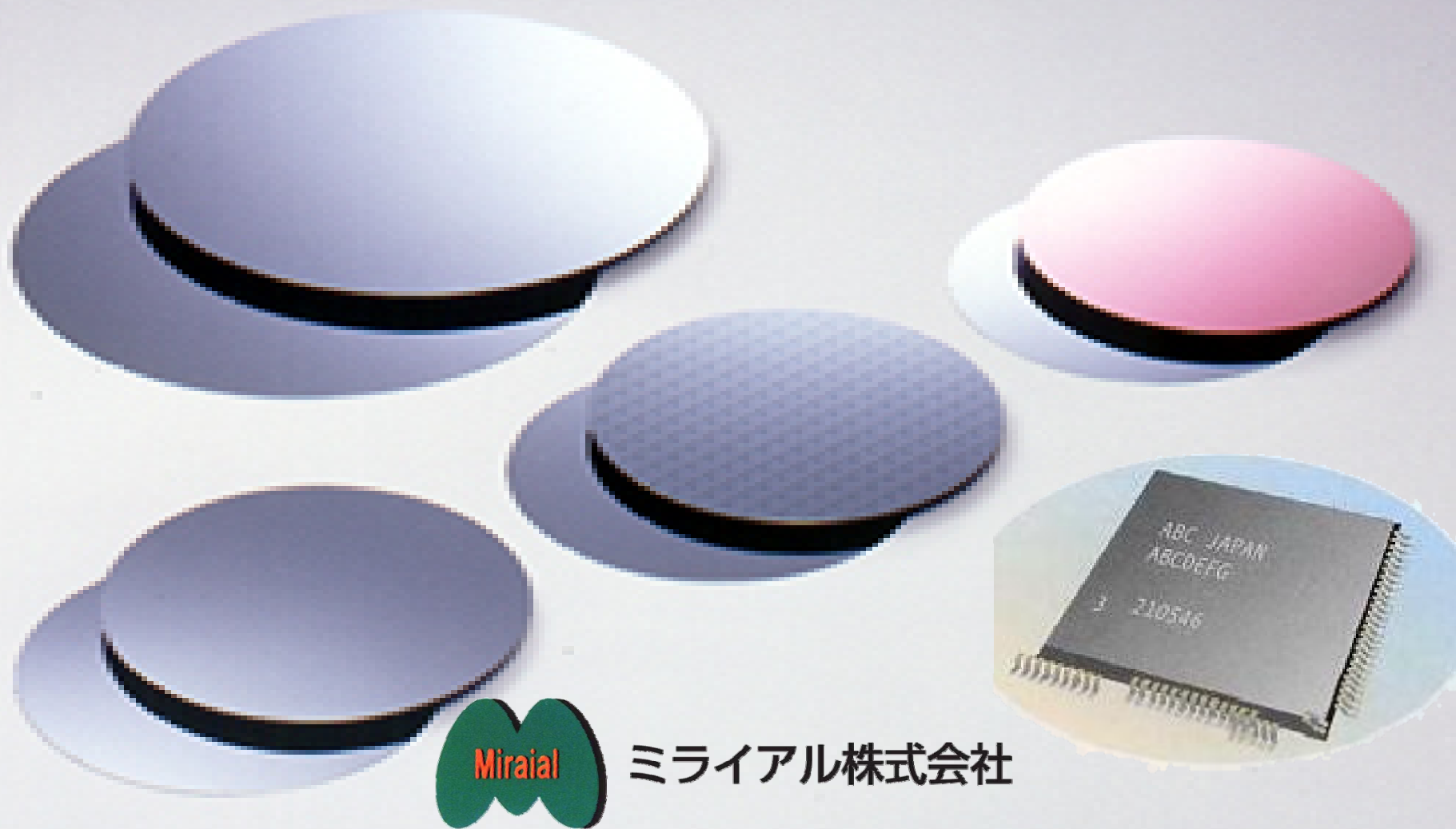


ミライアル株式会社

2006年7月中間期決算説明資料



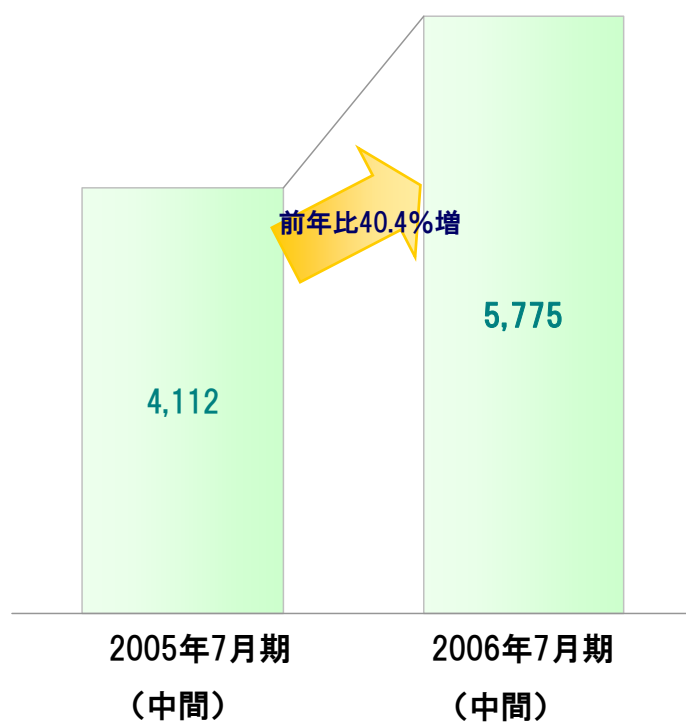
ミライアル株式会社

2006年7月中間期決算概要

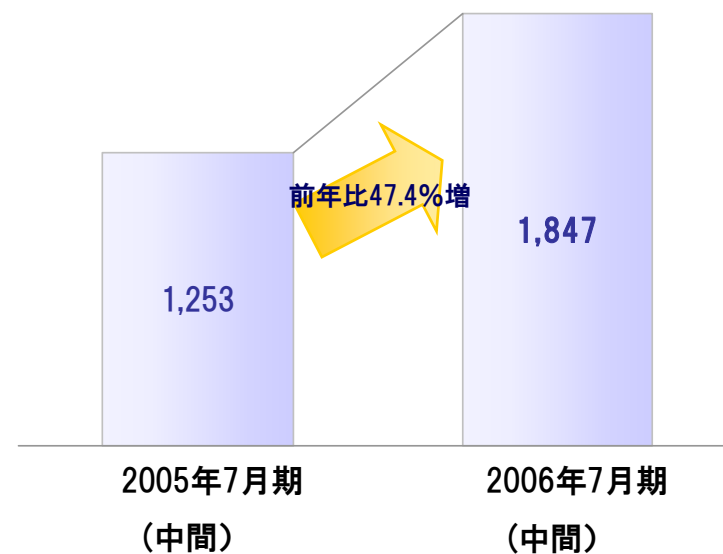
2006年7月中間期実績① 売上高・経常利益

売上高・経常利益とも目標を大幅達成

売上高 (単位:百万円)



経常利益 (単位:百万円)



2006年7月中間期実績② 損益計算書・事業別売上高

損益計算書

(単位:百万円・%)

	2005年7月(中間)			2006年7月(中間)		
	金額	構成比	前期増減比	金額	構成比	前期増減比
売上高	4,112	100.0	18.3	5,775	100.0	40.4
売上総利益	1,894	46.1	21.6	2,642	45.8	39.5
販管費	599	14.6	29.1	794	13.8	32.4
営業利益	1,294	31.5	18.3	1,848	32.0	42.7
経常利益	1,253	30.5	14.8	1,847	32.0	47.4
税引前(当期)純利益	1,267	30.8	20.4	1,846	32.0	45.7
(当期)純利益	772	18.8	20.4	1,091	18.9	41.2

事業別売上高

	2005年7月期(中間)			2006年7月期(中間)		
	金額	構成比	前期増減比	金額	構成比	前期増減比
半導体関連製品	3,593	87.4	23.9	5,147	89.1	43.3
フルイドシステム製品	294	7.1	▲19.5	423	7.3	43.8
その他	225	5.5	8.2	204	3.6	▲9.2
合計	4,112	100.0	18.3	5,775	100.0	40.4

2006年7月中間期実績③ 貸借対照表

(単位:百万円・%)

	2005年7月期(中間)		2006年7月期(中間)		増減額
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	7,791	65.7	8,521	59.8	730
現金及び預金	5,129		4,810		
受取手形及び売掛金	2,020		2,965		
棚卸資産	514		576		
その他	126		169		
固定資産	4,062	34.3	5,727	40.2	1,665
有形固定資産	3,554		4,070		
その他	507		1,656		
資産合計	11,853	100.0	14,249	100.0	2,395
流動負債	2,807	23.7	3,733	26.2	926
支払手形及び買掛金	975		1,362		
一年以内返済予定長期借入金	499		397		
その他	1,332		1,973		
固定負債	2,138	18.0	1,854	13.0	▲283
長期借入金	1,829		1,431		
その他	309		423		
負債合計	4,945	41.7	5,588	39.2	642
純資産合計	6,908	58.3	8,660	60.8	
負債及び資本合計	11,853	100.0	14,249	100.0	

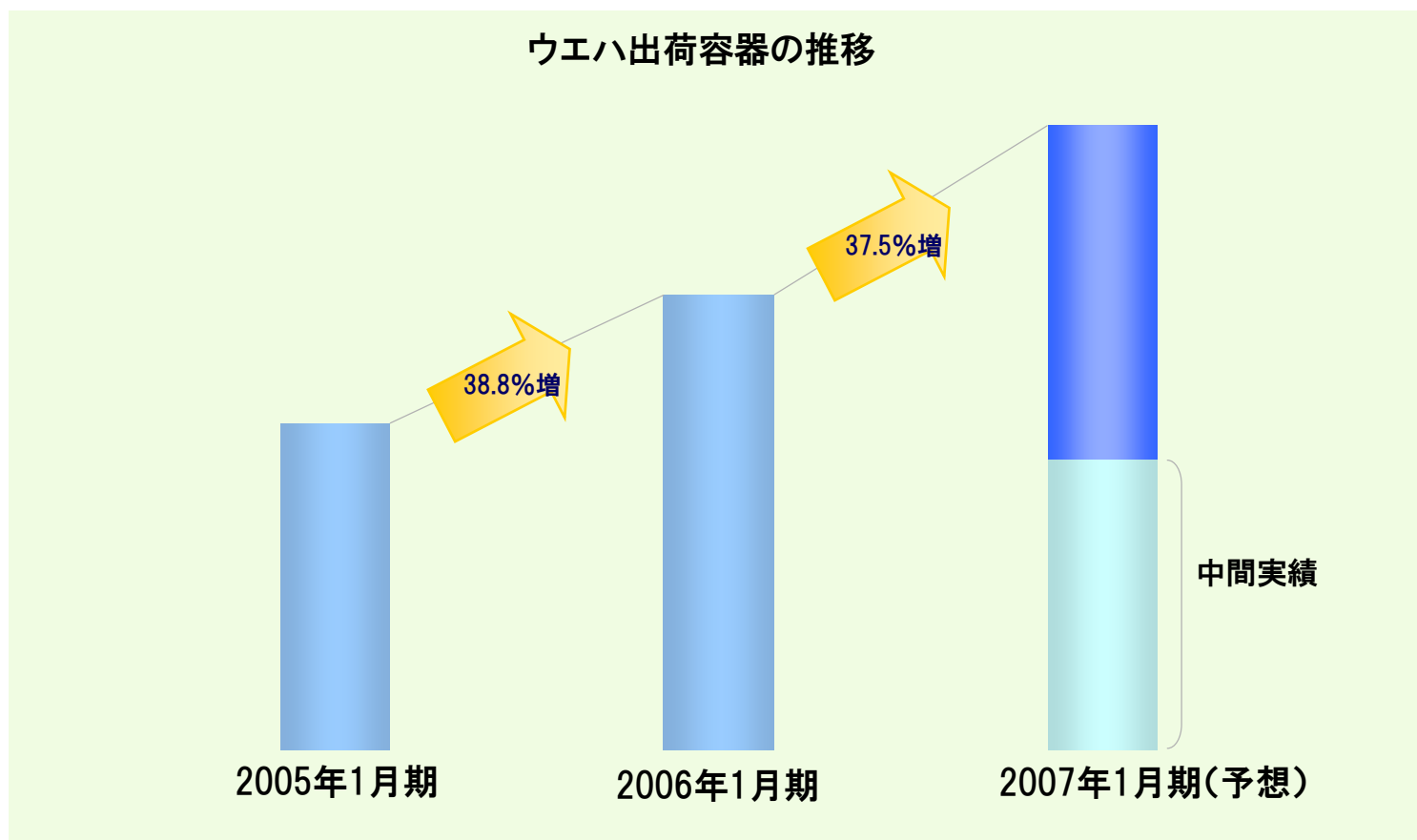
2006年7月中間期実績④ キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2005年7月期(中間)	2006年7月期(中間)	増減
営業活動によるキャッシュフロー	610	1,319	708
投資活動によるキャッシュフロー	▲529	▲476	53
財務活動によるキャッシュフロー	2,047	▲591	▲2,638
現金及び現金同等物期末残高	5,006	4,687	▲319

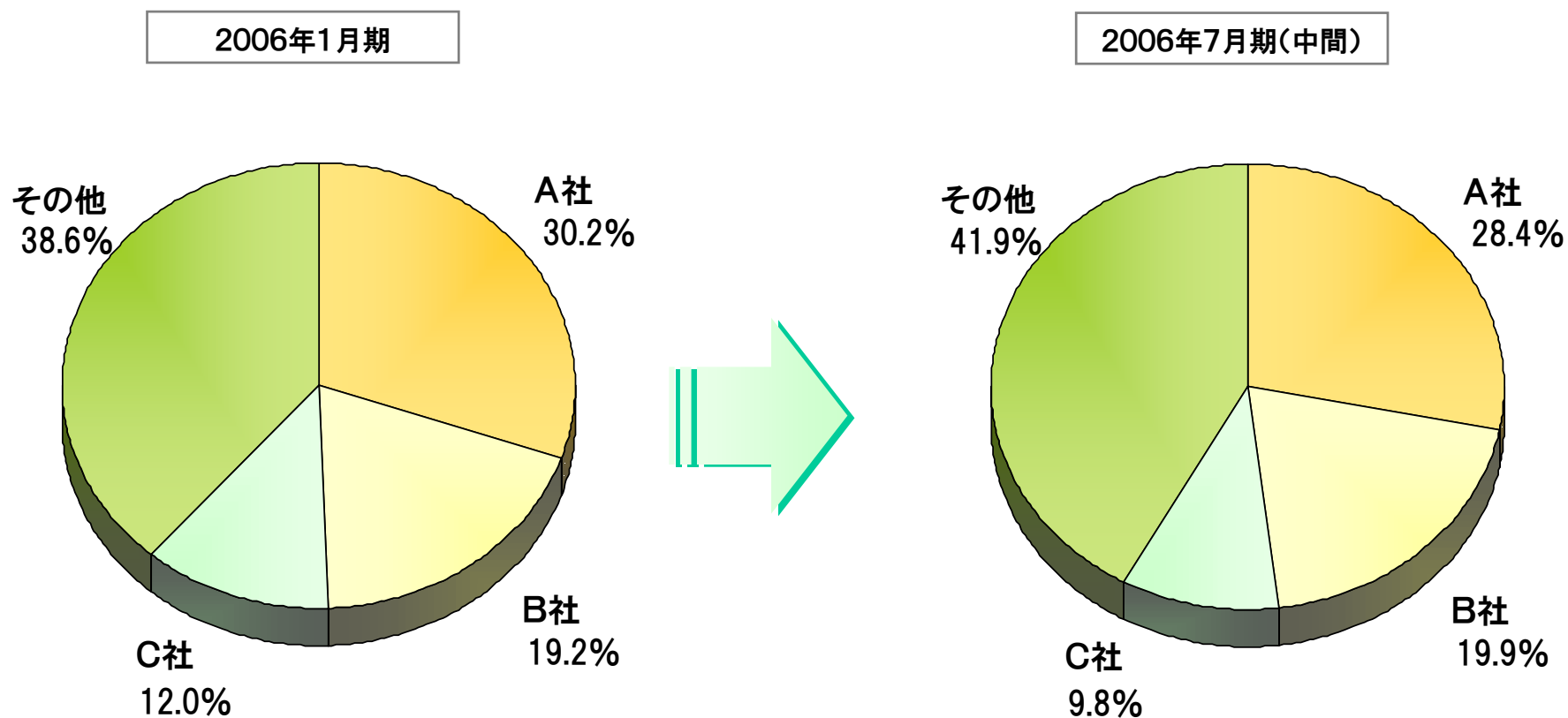
2006年7月中間期実績 ポイント① FOSB 販売好調

「FOSB」売上高前期対比約40%増の見込み



2006年7月中間期実績 ポイント② 主要顧客層の変化

主要顧客の売上高シェア

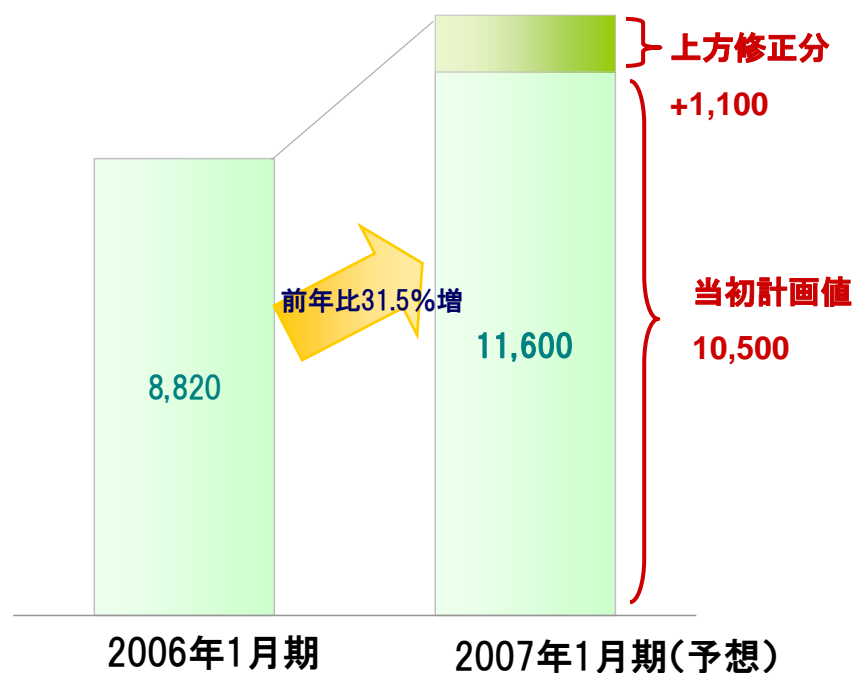


2007年1月期業績予想

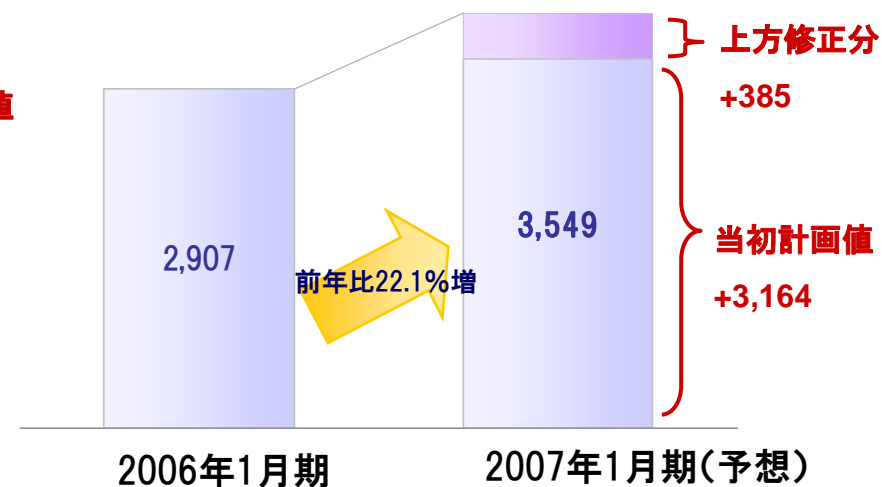
2007年1月期業績予想① 売上高・経常利益

当期業績予想を上方修正

売上高 (単位:百万円)



経常利益 (単位:百万円)



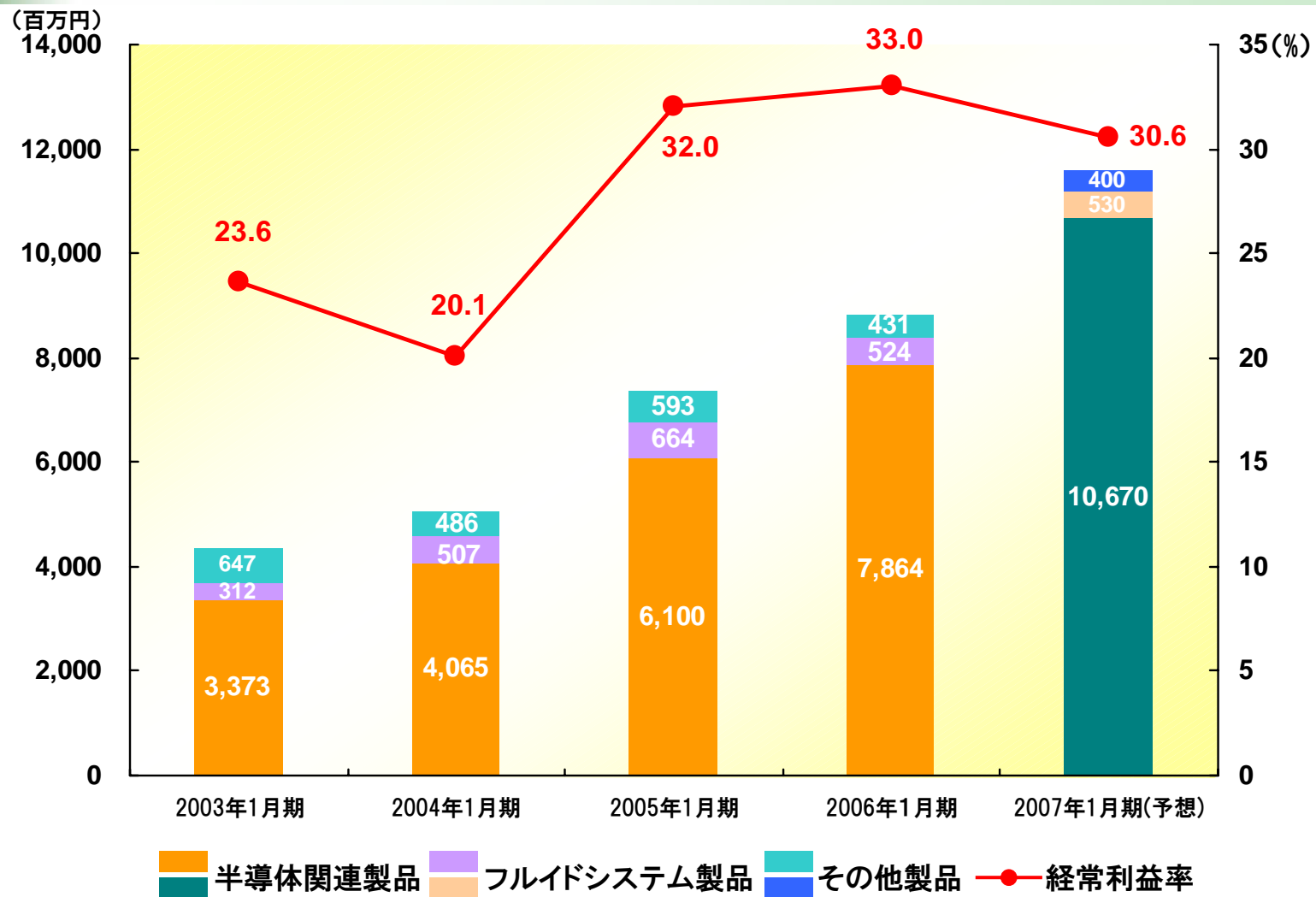
2007年1月期業績予想②

(単位:百万円・%)

	2006年1月期			2007年1月期(予)		
	金額	構成比	前期増減比	金額	構成比	前期増減比
売上高	8,820	100.0	19.9	11,600	100.0	31.5
売上総利益	4,186	47.5	25.5	5,116	44.1	22.2
販管費	1,242	14.1	29.6	1,556	13.4	22.1
営業利益	2,944	33.4	23.9	3,560	30.7	20.9
経常利益	2,907	33.0	23.3	3,549	30.6	22.1
税引前当期純利益	2,927	33.2	26.6	3,549	30.6	21.2
当期純利益	1,826	20.7	28.4	2,112	18.2	15.6

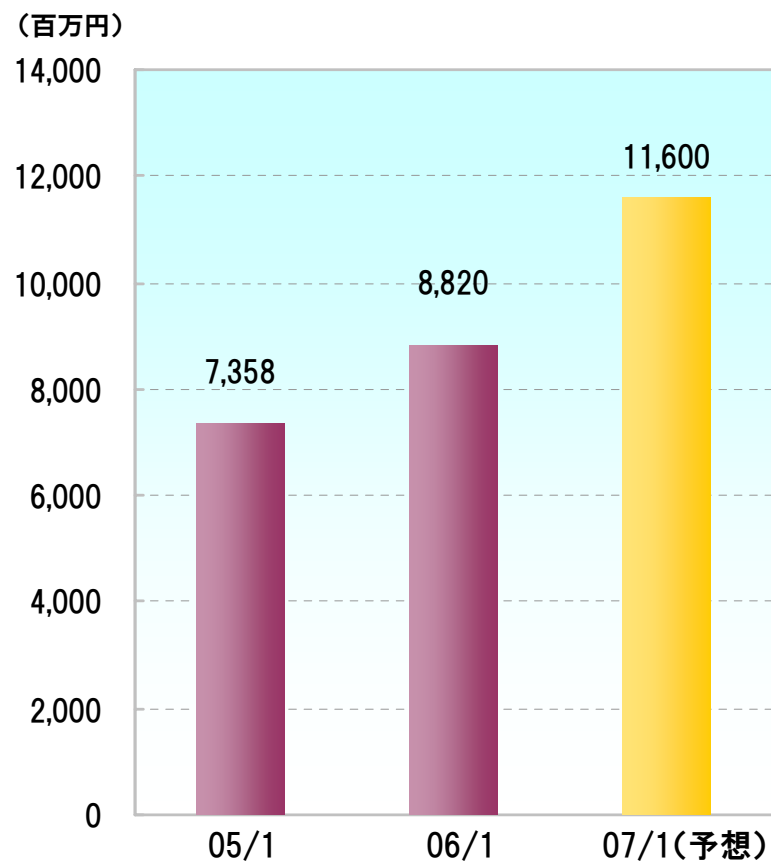
	2006年1月期			2007年1月期(予)		
	金額	構成比	前期増減比	金額	構成比	前期増減比
半導体関連製品	7,864	89.2	28.9	10,670	92.0	35.7
フルイドシステム製品	524	5.9	▲21.0	530	4.6	1.0
その他	431	4.9	▲27.3	400	3.4	▲7.3
合計	8,820	100.0	19.9	11,600	100.0	31.5

2007年1月期業績予想③

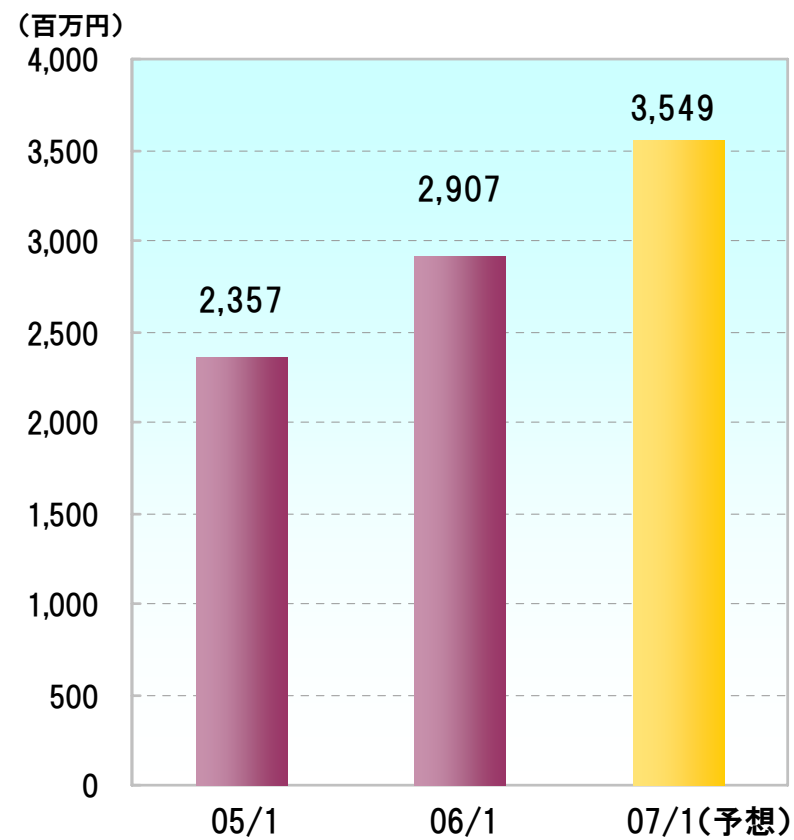


業績推移

売上高推移



経常利益推移

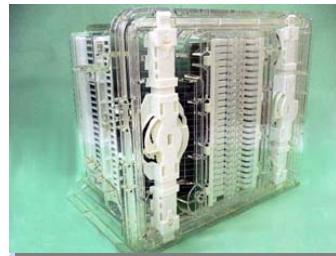


今後の事業戦略

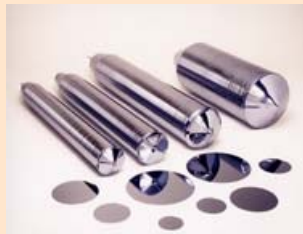
業界環境

高い機密性と高純度な収納環境を実現

300mm FOSB
原料メーカーで製造された300mmウエハを
デバイスメーカーに出荷



ウエハメーカー



シリコン単結晶とウエハ

デバイスメーカー



ウエハ



半導体デバイス

静電気でゴミや埃がウエハに付着
しないよう独自の機能性導電プラ
スチックを採用

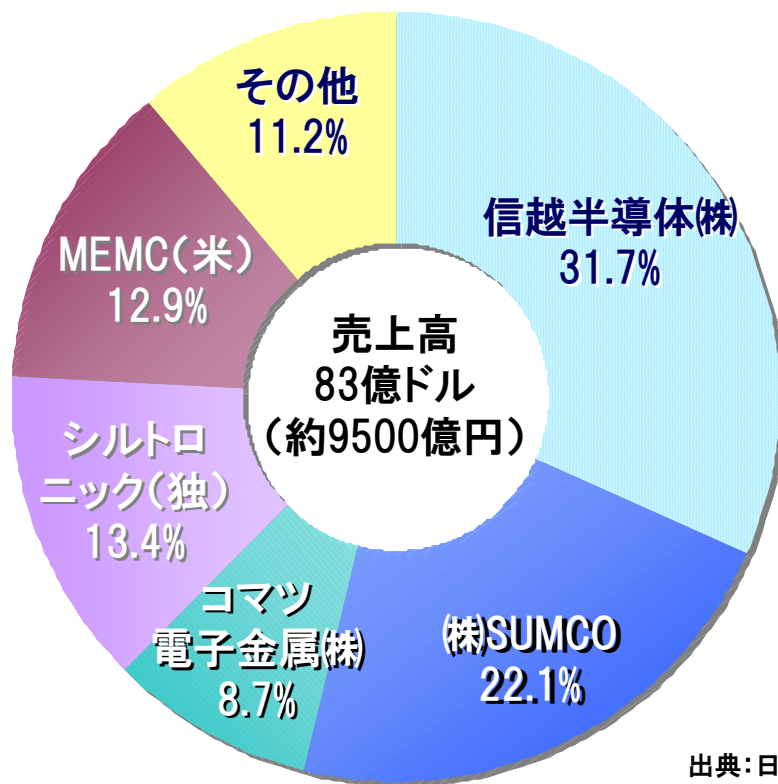


300mm FOUP
半導体デバイス製造の工程内で
ウエハを搬送

業界環境

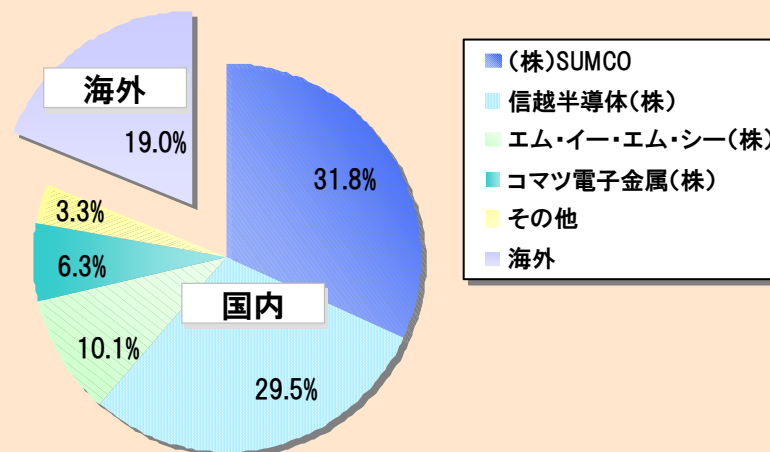
シリコンウエハの世界生産の動向 ～日本での生産が7割～

シリコンウエハの世界シェア(2005年)

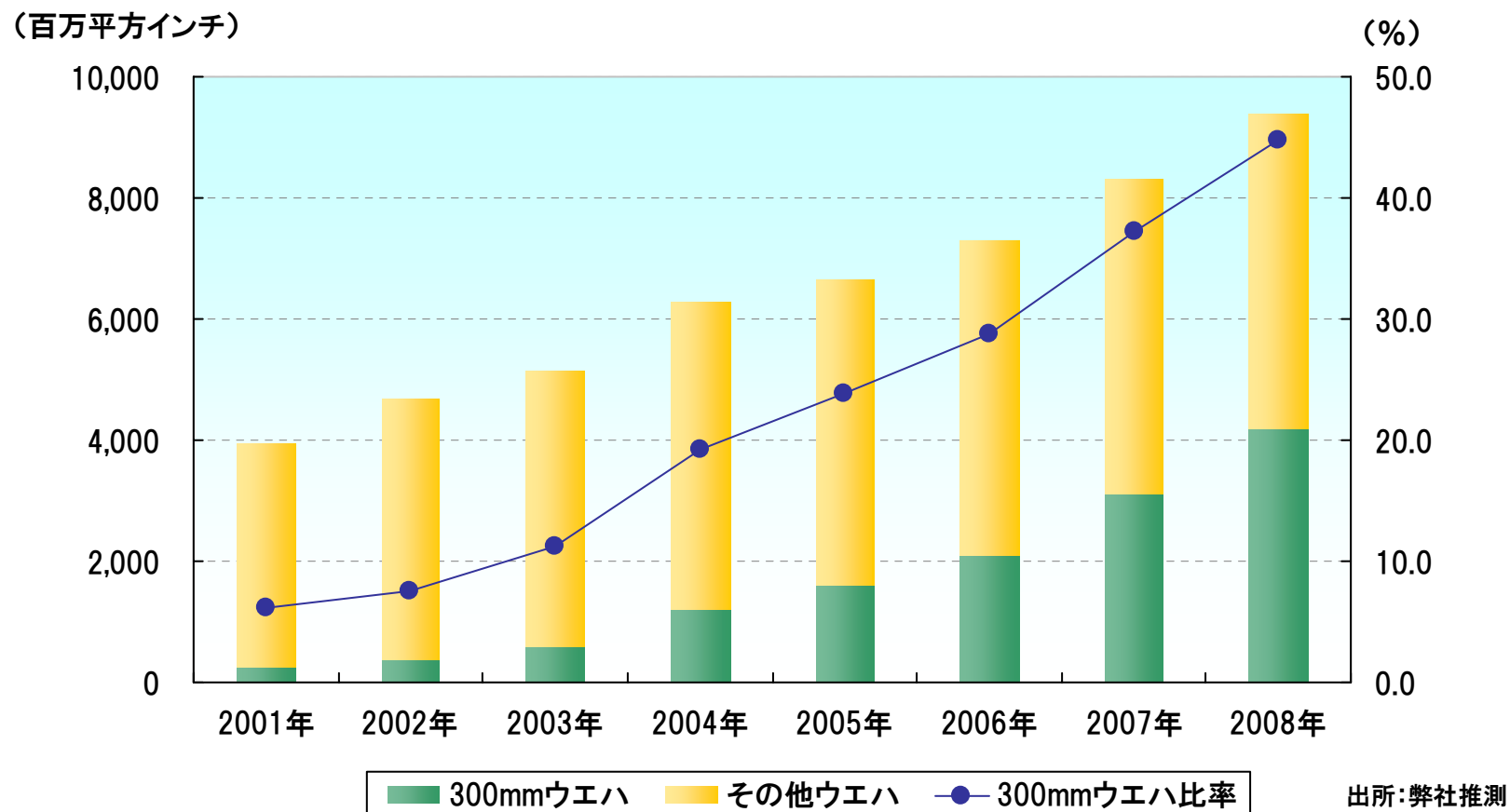


出典: 日本経済新聞

FOSB出荷実績得意先別シェア



シリコンウエハ生産動向



今後の事業戦略

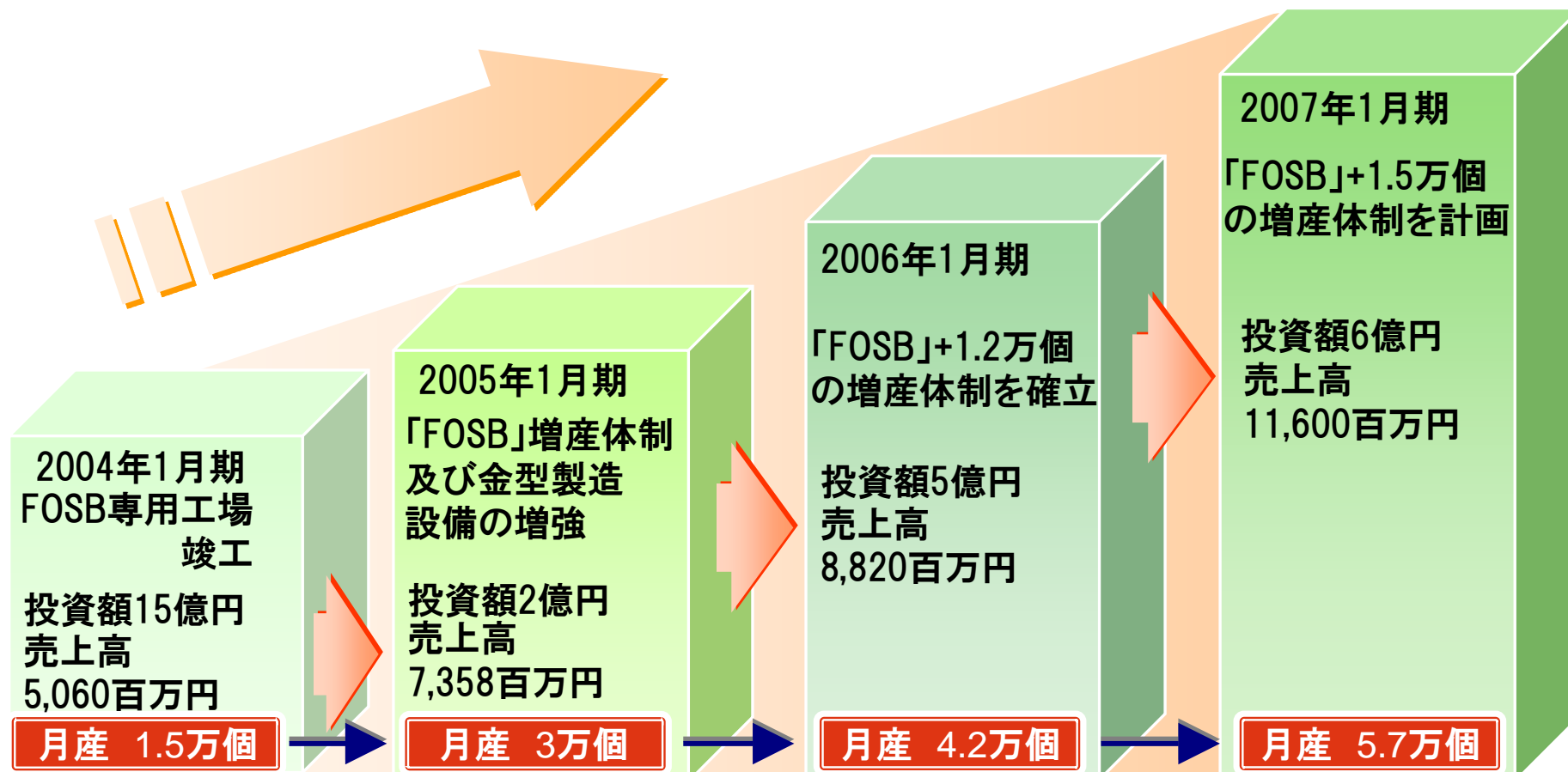
設備を増強し、供給体制の強化を図る

生産効率の向上を図る

販売を強化し売上高・利益高 NO.1を目指す

今後の事業戦略① 設備を増強し、供給体制の強化を図る

設備投資計画・・・「FOSB」15,000個の増産体制の確立を目指す



今後の事業戦略② 設備を増強し、供給体制の強化を図る

新工場の建設「住吉第三工場(仮称)」

名 称	住吉第三工場(仮称)	
所 在 地	熊本県菊池市泗水町住吉(住吉工業団地内)	
面 積	敷地面積	14,280㎡
	総延べ床面積	6,582㎡
生 産 能 力	300mmシリコンウエハ関連製品 月産26,000個	
工 事 計 画	着工予定時期	平成18年10月
	完成予定時期	平成19年 5月
設 備 投 資 額	総額20億円(建物、機械設備等)	
資 金 計 画	全額自己資金	



今後の事業戦略③ 生産効率の向上を図る

製造ラインの効率化

ジャストインタイムの強化

ストックコンベア、ラインコンベアの導入

金型真空装置の導入

成形後の仕上げ作業の削減

製造組織の強化

人材の強化

- ・社員教育に注力し、成形・金型技能士九州地区最多
1級・2級 計36名（2006年7月時点）
- ・QCサークル活動の強化

生産効率の向上

今後の事業戦略④ 販売を強化し売上高・利益高 NO.1を目指す

200mm市場で築いた信用力を武器に300mm周辺製品市場を拡販

SEMI規格外のシリコンウエハ周辺製品を新規開発

受注製品群



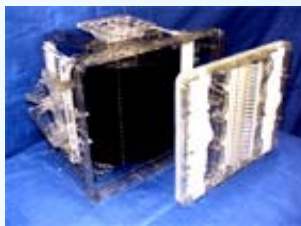
化合物半導体用
枚葉ケース

SEMI規格品

デバイス
工程内処理



運搬



300mm極薄ウエハ用
トレーサブトレイ



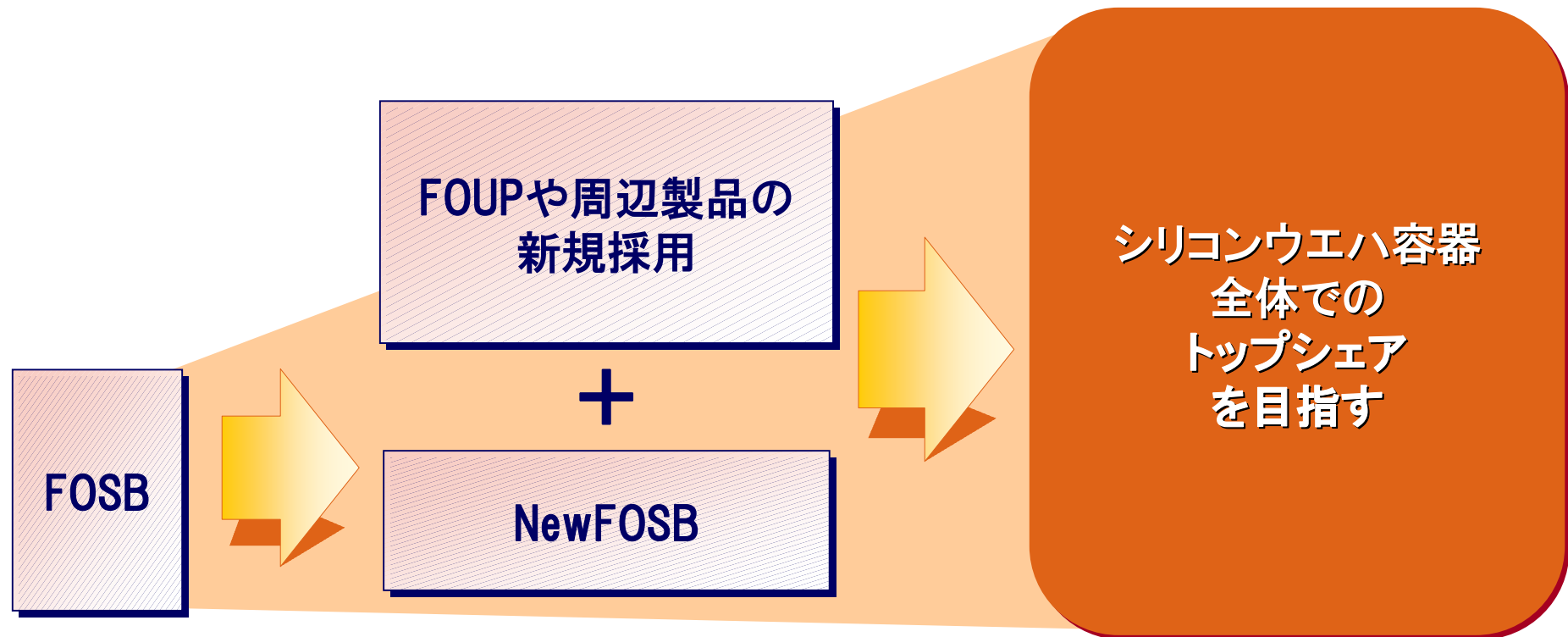
300mm枚葉ケース



薬液処理工程

今後のビジョン シリコンウエハ容器全体のシェアアップを図る

NewFOSBを中心に
シリコンウエハ容器全体のシェア向上を目指す



ご参考資料

会社概要

ミライアル株式会社(英訳名:Miraial Co., Ltd.)

設立 : 1968年7月

本社 : 東京都豊島区西池袋一丁目18番2号

代表者 : 代表取締役社長 兵部 行遠(ひょうぶ ゆきひろ)

事業内容 : 半導体業界を中心に、シリコンウエハ容器、フルイドシステム、電子部品等
のプラスチック精密成形品の製造及び販売



NewFOSB



FOUP

沿革

年代 重要イベント(会社の歴史)

- 1968年 会社設立
- 1969年 国産第1号となるシリコンウエハ用カセットの開発・製品化に成功
- 1984年 シリコンウエハ用カセットの大幅な生産拡大を図る為、現熊本事業所(富の原工場)を開設

1995年 SEMIスタンダード会議
ニューオリンズ(300mm規格)

- 1996年 ISO9002認証取得
- 1999年 300mmシリコンウエハを使用した半導体(IC)製造にあわせて、300mmウエハ出荷容器の「FOSB」WIN300を開発・発売
- 2001年 住吉工場第1竣工
- 2002年 ISO9001認証取得
- 2003年 社名変更 ミライアル株式会社
住吉工場第2 竣工
- 2004年 ISO14001認証取得

(製品)



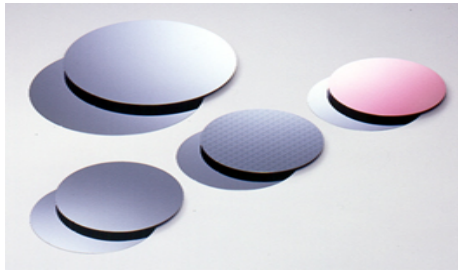
フッ素樹脂製
工程内カセットを製品化

日本初
SEMI規格300mm
FOSB開発



SEMIFIMS規格
New FOSB

事業内容①-1 半導体関連製品事業



ウエハメーカー

デバイスメーカー

製造時

出荷時

搬入時

工程搬入時

製造時

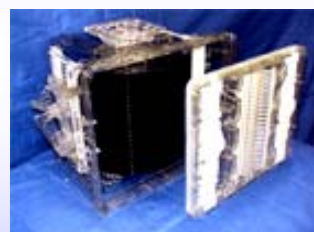
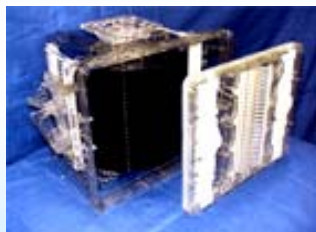
カセット

FOSB

FOSB

FOUP

カセット



事業内容①-2 半導体関連製品事業

200mm以下

■ 工程内容器

薬液処理工程 …… フッ素樹脂

非薬液処理工程 …… 特殊PP、PBT、PEEK

■ 出荷容器 …… PC、PBT



300mm

■ 工程内容器

薬液処理工程 …… フッ素樹脂

非薬液処理工程 …… 特殊PP、PBT
PEEK

■ 出荷容器 …… PC、PBT



FOUP

FOSB



事業内容② フルイドシステム製品事業 その他製品事業

フルイドシステム製品事業



高耐熱、耐薬品の特長を持つフッ素樹脂の継手、バルブ、ポンプ等のフルイド製品
半導体(IC)製造・ラボなどで腐食性の強い薬液を、純度を保ち安全且つ確実に移送する



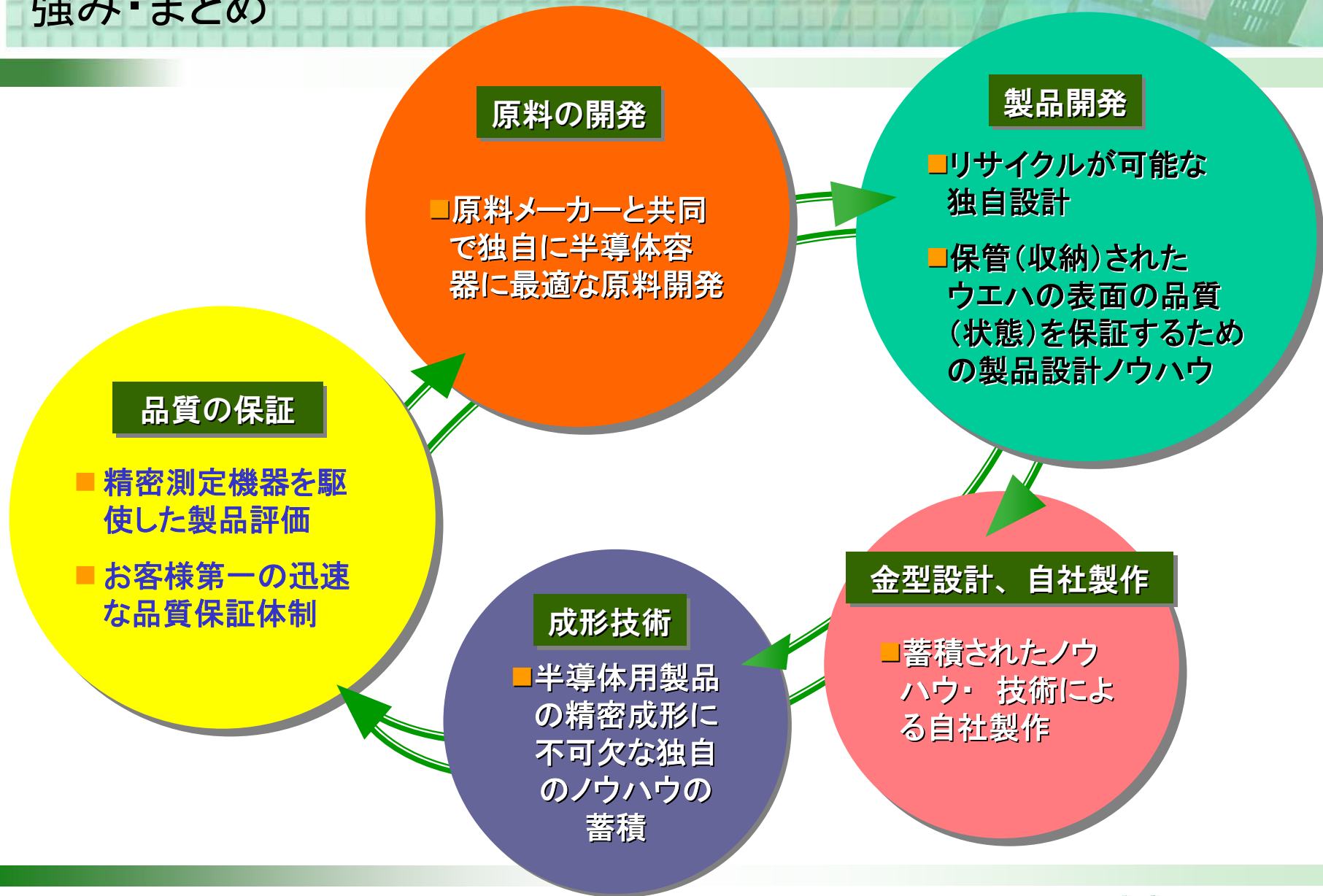
その他製品事業



高機能プラスチックの特性を活かした合成樹脂製品
電子、通信、計測機器、航空、宇宙分野等で使用



強み・まとめ



強み① 製品設計、金型製作、成形加工に至るまでスピード製品開発による一貫生産

業界で唯一、製品形状モデル検討から、
金型設計、金型製作、成形までを自社技術で完結



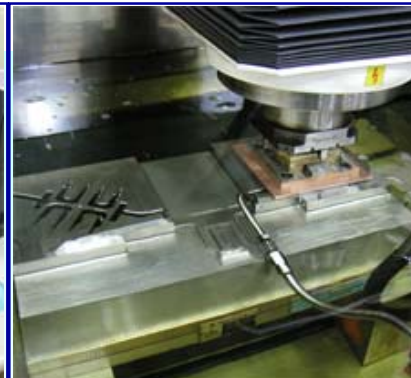
製品設計

高機能プラスチック
製品製造で培ったノ
ウハウと、最新鋭の
3D/CAD・CAEシス
テムを融合した独自
の設計技術を開発



金型設計

製品設計に直結、
動した金型用
3D/CADシステムを
装備



金型製作

小型成形用金型か
ら300mmシリコンウ
エハ出荷容器の大
型成形用金型まで
生産が可能



成形

フッ素樹脂の成形設備
の開発等で培った蓄積
された成形技術を基礎
とし、半導体業界用の
高機能プラスチック製
品の生産体制を確立

強み②

成形技術

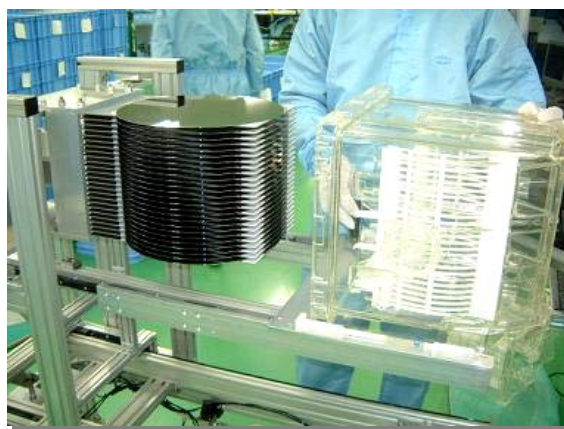
大型製品の精密成形技術

成形難易度が高い高機能プラスチックの成形技術

発塵や汚染のないクリーン成形技術



製品成形



高度な検査装置で精密検証



精密な検査を可能にする特注検査装置

強み③

オリジナル原材料の開発

主要原材料の使用量

汎用プラスチック樹脂
(PP,シールスタット)

7.3%

高機能プラスチック樹脂
(PEEK,PBT,PEE,PC,POE
PFA,ETFE)

92.7%



半導体製造プロセスの変革
に伴う高機能樹脂素材への
ニーズの高まり

樹脂原料メーカーとの共同開発による
当社独自のオリジナル原料

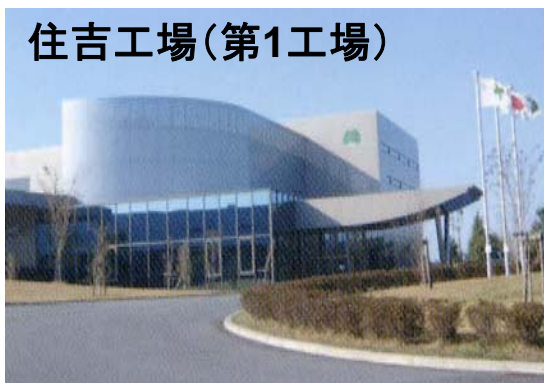
高純度製品の提供

強み④ 世界へ発進する生産拠点

アジア戦略をにらみ、熊本に生産体制を確立

地理的優位性を最大限に発揮し、
デバイスメーカーとのリレーションの強化、海外販売強化を図る

住吉工場(第1工場)



住吉工場(第2工場)



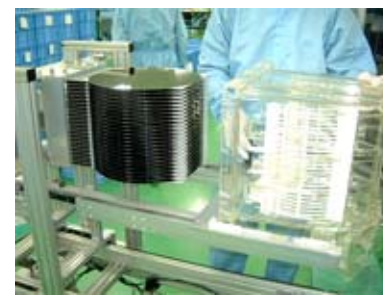
富の原工場



強み⑤ 充実した生産設備

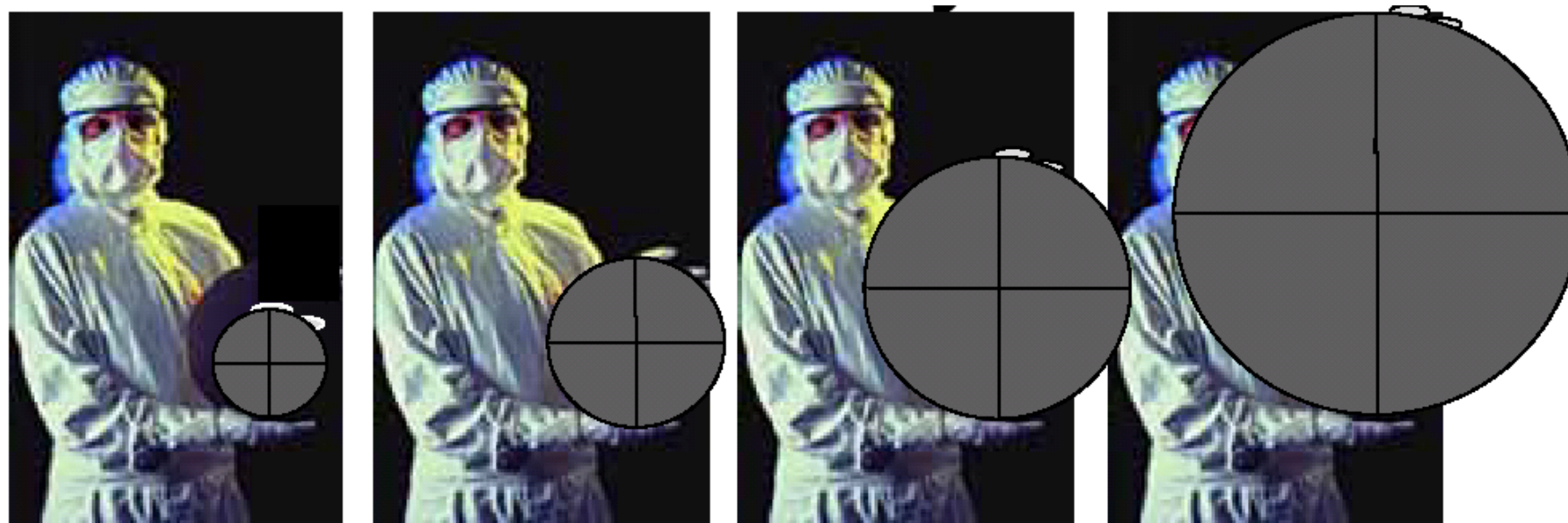
クリーンルームを備えた最先端工場

万全な品質保証体制 (ISO9001 認証)



シリコンウエハのロードマップ

ミライアル製品のデファクトスタンダード化を実現し
ポスト300mm戦略を優位に進める



200mm
1990年～

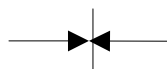
300mm
2001年～

450mm
2012年～

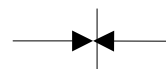
675mm
2019年?～



11年



11年



9年



出典: ITRS

経営理念・環境方針

経営理念：私達は事業活動を通じて

1. 人と自然を大切にしあらゆる人々に愛され社会の発展に貢献します
2. 先端技術をもって開発を推進し世界の人々に喜ばれる価値を創造します

環境方針

1. 製品の環境負荷を軽減
2. 省資源・省エネルギー活動の推進
3. 環境関連法規則等の遵守
4. 環境保全活動の推進
5. 啓蒙活動の推進

ISO14001認証取得(2004年1月)

「ミライアルの未来」

明日に向かって

「未来を見つめ」「未来を考え」「未来を創る」

夢と創造に挑戦

IR問い合わせ窓口

ミライアル株式会社

管理本部 総務経理部

TEL: 03-3986-3782

FAX: 03-3986-3853

E-mail: ir-m@miraial.co.jp

将来見通し等に関する注意事項

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。